

2026年4月16日（木）

2026年度CGDP第1回講習会

「次世代半導体デバイス加工の現状と課題、そして将来に向けて」が、
2026年4月16日に開催されました。

当日はハイブリッド開催で約60名の会員の皆さまにご参加いただきました。今回は、次世代半導体デバイスプロセスの現状と将来課題をテーマに、3Dフラッシュメモリ製造技術や高精度エッチング技術、デジタルトランスフォーメーションによる環境負荷低減手法などに関する講演が行われました。講師にはキオクシア（株）、（株）日立ハイテク、東京エレクトロン宮城（株）の専門家が登壇し、産業界の最新動向と今後の技術展望が紹介されました。続いて、現地開催のみのパネルディスカッションでは、AI時代に求められる半導体技術について活発な議論が交わされました。さらに、その後の交流会では、賑やかな雰囲気の中で参加者同士の交流が深まり、産学連携を促進する有意義な機会となりました。



講演の様子



総合討論の様子（現地実施のみ）

会員さまの声

分からないからこそ、あらゆる可能性を試す。得られる膨大なデータは、人ではなく機械に任せる。そのために、AIが必要ではないかと思っています。

社内ではなかなか情報収集が難しい中で、このような場では学術的な内容も含め、自由にさまざまなお話を伺うことができ、大変参考になりました。

環境負荷を下げることへの要求は非常に高い一方で、製品に求められる条件が多く、簡単に置き換えられる材料が見つからないのが現状です。そのため、より環境に配慮した材料開発が重要だと感じました。

プロセス開発においては、技術的な視点だけでなく、環境やエネルギー削減といった観点も重視されていることがよく分かり、非常に勉強になりました。



交流会の様子

今後の講習会情報

次回開催：2026年6月12日（金）

テーマ：フィジカルAI関連

最新情報は[グリーン・DXプラズマコンソーシアム（CGDP）のホームページ](#)でチェックしてください